

3種類の中から、最適なチップソルダーを選択

Choose the optimum chip solder from among three types

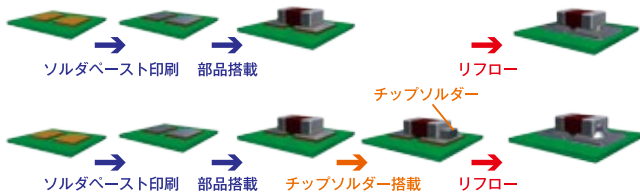
特長

- SMDと同時に自動搭載可能なテーピング仕様
- ソルダペーストと同時に溶融、追いはんだ付けが不要
- 適切なはんだ量の供給で、高い接続信頼性を確保



仕様

● チップソルダーを自動搭載、同時溶融

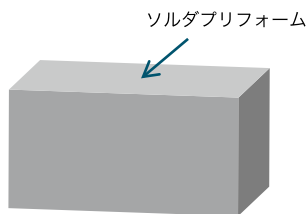


● 大型部品の接合補強に



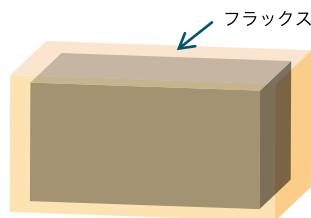
● 3種類の中から、用途に応じて選択

チップソルダー



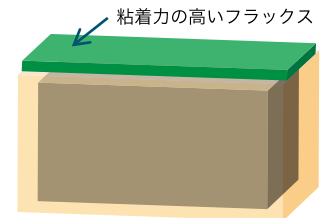
- ・ソルダペースト上に搭載・溶融
- ・低価格仕様

フラックス・コーテッド チップソルダー Type A



- ・はんだ濡れ性を向上
- ・リフロー炉での再酸化抑制
- ・大気リフローも可能

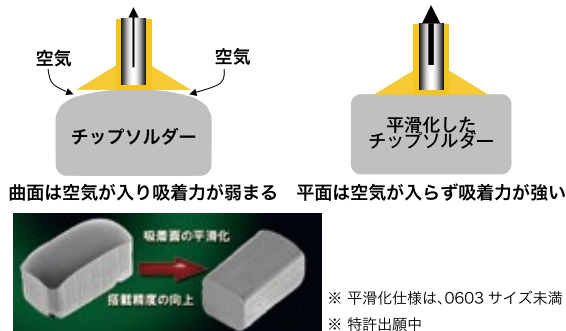
フラックス・コーテッド チップソルダー Type B



- ・銅ランドや部品に直接搭載・溶融

参考出展

● 吸着面を平滑にして搭載精度を向上



● チップソルダー寸法公差

(単位 :mm)

	l	w	t
0402	±0.05	±0.05	±0.05
0603	±0.1	±0.1	±0.05
1005	±0.1	±0.1	±0.05
1608	±0.1	±0.1	±0.05